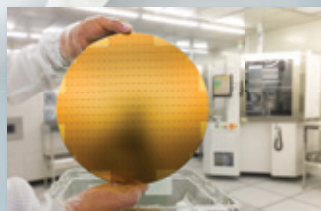
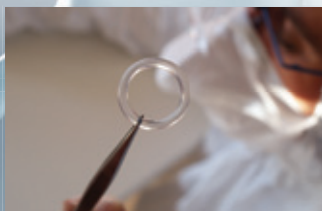


# イソラスト PureFab™ JPF30



## 過酷な半導体製造プロセス向け最先端半透明シール材料

イソラスト PureFab™ JPF30は、半導体製造プロセスの中でも最も過酷なアプリケーション向けに開発された、高純度の半透明パーフロロエラストマー (FFKM) 材料です。その他の充填材を入れていない半透明FFKM材料との比較試験結果から、優れた圧縮永久歪み特性を有する材料となっています。

イソラスト PureFab™ JPF30は、最大+300℃(+572°F)までの高温環境下であっても、長期にわたり堅牢なシール性を発揮する材料となっています。

さらに、充填材を含まないため、イソラスト PureFab™ JPF30は、ウェハーの近くでエラストマー製品を使用する用途でも大変優れたパーティクル性を発揮します。

独自の架橋技術と耐薬品に優れたポリマー主鎖により、優れたアウトガス特性を発揮するため、過酷なチャンバー部やプロセスにおいて、望ましい材料となっています。

## 特長

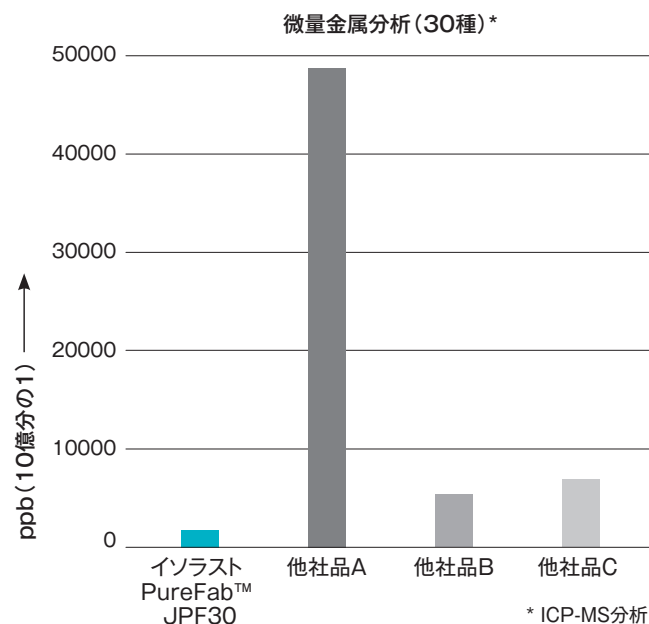
- 充填材を使用していない
- 半透明
- 独自の材料組成により、最高クラスの圧縮永久歪み特性と圧縮応力緩和 (CSR: Compressive Stress Relaxation) 特性を有する
- 金属溶出が極めて少ない
- プラズマクラックに対する優れた耐性
- パーティクル発生が少ない
- アウトガスが極めて少ない
- 優れた耐薬品性
- 連続動作温度+300 °C / +572 °Fまでの優れた熱安定性

## 主な用途

- エッチ プロセス: ALE、ドライ エッチング、ストリッピング
- チャンバーのリッドシール
- ガス導入部のシール
- スリットバルブのドア用シール

## 純度

イソラスト PureFab™ JPF30は、高い純度を発揮する材料であることから、先端の半導体製造プロセスにおいても高い歩留まりを実現します。

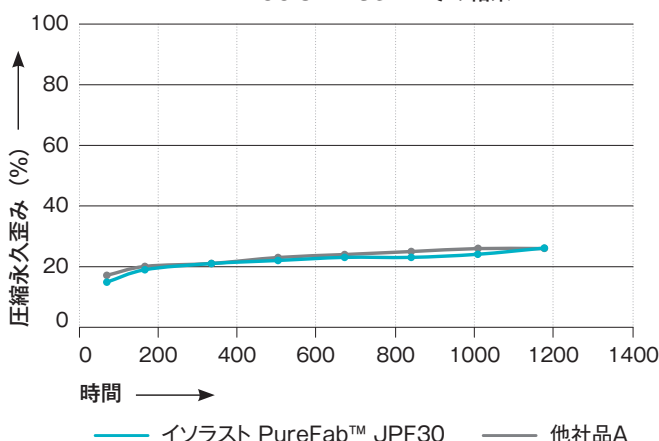


一般データ	JPF30
エラストマータイプ	FFKM
色	半透明

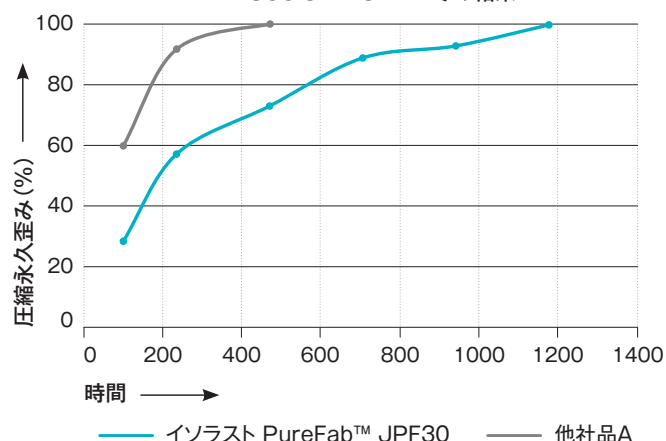
パラメータ	試験方法	結果
硬度 (Shore A)	D2240	53
引張り強さ (MPa)	D1414	9.1
破断伸び (%)	D1414	202
100%モジュラス (MPa)	D1414	1.37
圧縮永久歪み (%)		
72h @+200 °C/+392 °F		15
72h @+250 °C/+482 °F	D395	17
72h @+300 °C/+572 °F		28
最高使用温度 (連続運転時)		~ +300 °C /+572 °F

### 圧縮永久歪み

+200°C / +392°Fでの結果



+300°C / +571°Fでの結果



トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、数十年にわたるエンジニアリングとアプリケーションの経験に加えて、過酷な半導体製造プロセス向けの高精度でカスタマイズされたシール製品の設計に関する最新の知識を提供します。

イソラスト PureFab™ シリーズは、プラズマや高温環境下において最高クラスの高純度をほこるシール性能を実現し、プロセス薬品、アプリケーション、複雑な半導体製造プロセスの要求項目にお応えするため、用途ごとに独自の材料をそろえています。

各国ごとの営業員と半導体業界専門の社員、そしてグローバルでのサポートという3つの柱により、設計、試作品提供、そして量産にいたるまでシール業界トップクラスのサービスを提供いたします。このサービス体制に加え、様々なデジタルツールを提供しており、お客様の業務効率向上に貢献しています。



詳細な情報やご連絡先については上記のQRコードをスキャンいただくか下記弊社Webサイトをご覧ください。  
www.tss.Trelleborg.com/jp



WWW.TSS.TRELLEBORG.COM/JP

日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズ 株式会社  
東京:03-5633-8008 大阪:06-6821-0077 名古屋:052-212-5731